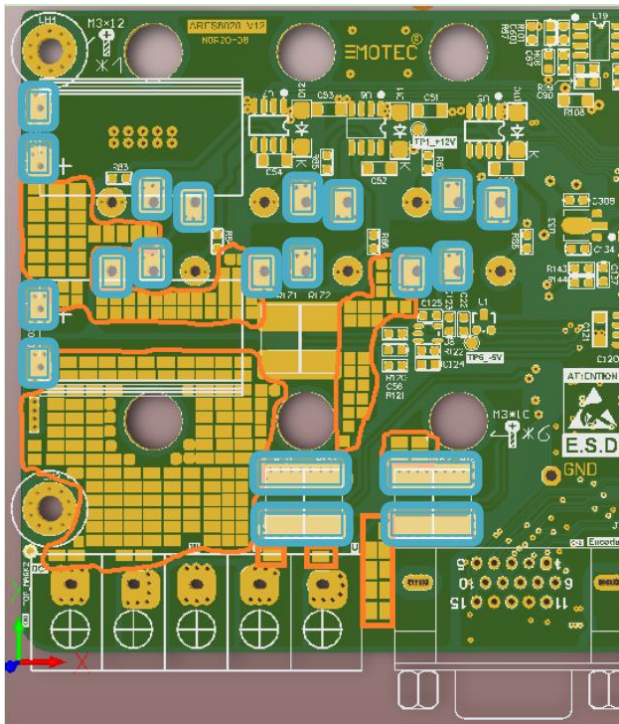




PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES-N-ETHERCAT	焊接	QM03321022401	V5	1/1	2022-5-18



线路板正面



线路板背面

- 1)  橙色框内 PAD 加锡，加锡厚度为 0.2mm；
- 2)  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内上下焊锡通透（灌满焊锡）；
- 3) CN1 端子，底层加锡焊接，焊锡熔化后，电烙铁仍要停留 2~3 秒，保证焊锡从过孔完全流到板子顶层。
- 4) 功率管 Q1~Q6 共计 6 个（TO-247 封装的管子），管脚直角折弯，
- 5) 有型号标识的面紧贴线路板焊接，且要求功率管脚顶层和底层双面焊接；
- 6) 焊接后，功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴；
- 7) 电解电容 C100 和 C101；
- 8) 按照丝印标识折弯管脚，卧式贴线路板焊接，注意两个电解折弯方向相反；
- 9) C100 和 C101 电解电容与 PCB 接触面涂覆 704 黑色固定胶，点胶不要过量；
- 10) 变压器 T1 焊接前，要对管脚的平整度进行调整，避免出现管脚虚焊和变压器焊接后，不在同一平面上；
- 11) 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；
- 12) 所有极性元件，严禁方向反；
- 13) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
- 14) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
- 15) 手工操作要做防静电处理；
- 16) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
- 17) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件